www.topoint.tw

Top the Perfection. Point to the Future.

尖點科技股份有限公司
股票代號: 8021. TW

2026 Q3營運說明

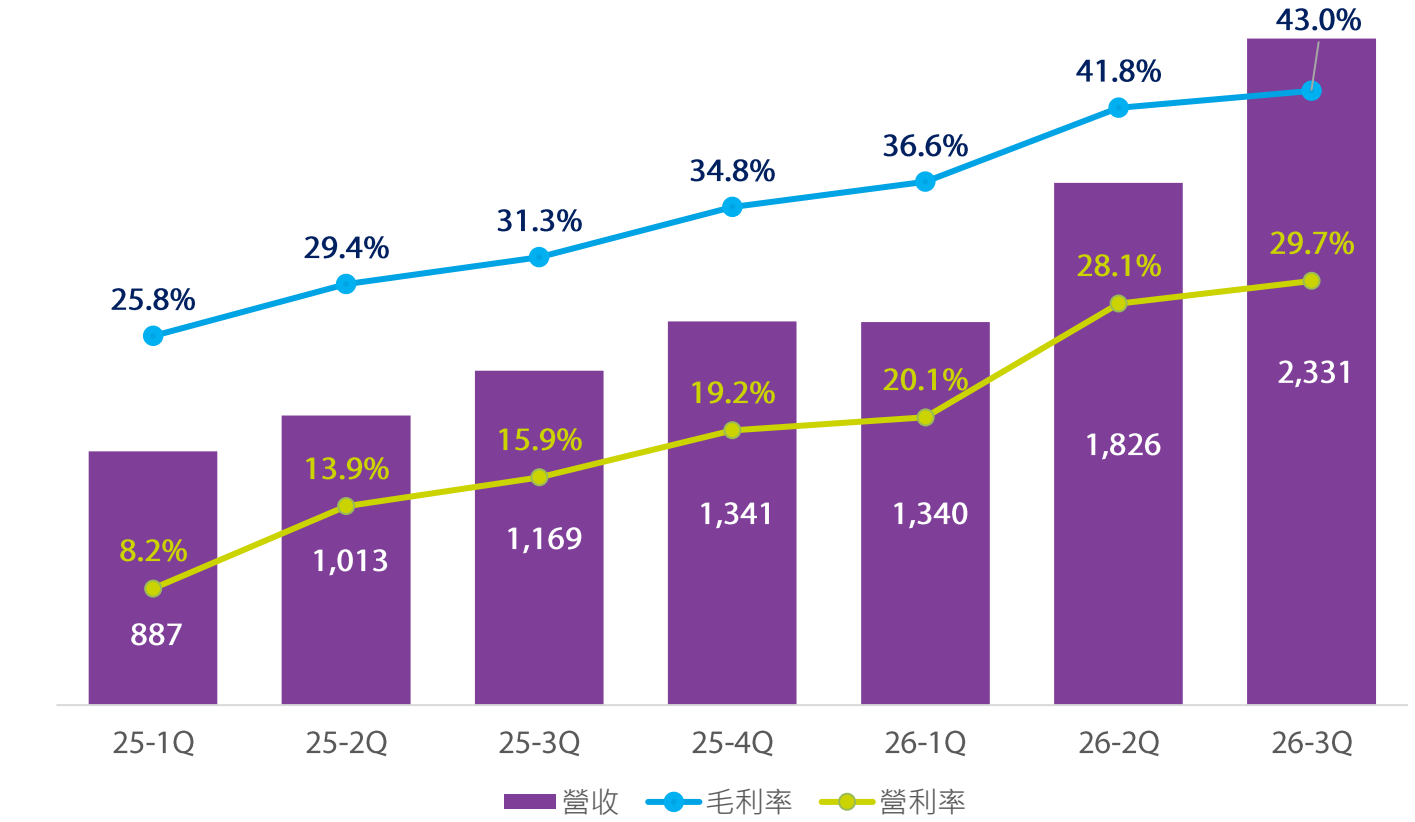
日期：2026/11/6

免責聲明

本報告內容係依現有資訊而做成，其中的財務或相關資訊可能包含一些對本公司及其子公司未來前景的說明，這些說明易受重大的風險和不確定性因素影響，致使最後結果與原先的說明迥異，故本公司特此聲明，本報告中的內容，僅為資訊流通之目的而公佈，並非投資建議，本公司不對報告內容的正確性、完整性或任何使用本報告內容所產生的損害負任何責任。

營收與獲利趨勢

單位：新台幣百萬元



TOPOINT All Rights Reserved

合併綜合損益表 – 按季別

NT$ 百萬元	3Q-25	4Q-25	1Q-26	2Q-26	3Q-26	QoQ	YoY
營業收入	1,169	1,341	1,340	1,826	2,331	27.6%	99.4%
營業毛利	366	467	490	763	1,001	31.2%	173.5%
營業費用	183	209	218	261	306	17.4%	67.5%
營業利益	186	258	270	513	691	34.8%	271.4%
稅前淨利	193	259	270	518	688	32.7%	256.9%
淨利歸屬於本公司業主	109	150	169	302	428	41.7%	291.4%
EBITDA	287	354	371	623	807	29.5%	181.2%
EPS (元)	0.77	1.06	1.17	2.08	2.92	40.6%	277.6%
毛利率%	31.3%	34.8%	36.6%	41.8%	43.0%	+1.2 ppt	+11.7 ppt
營業利益率 %	15.9%	19.2%	20.1%	28.1%	29.7%	+1.6 ppt	+13.8 ppt
淨利率%	9.4%	11.2%	12.6%	16.5%	18.4%	+1.9 ppt	+9.0 ppt

* 2026年第三季加權平均流通在外股數為1億4仟7佰萬股

TOPOINT All Rights Reserved

合併資產負債表

NT$ 百萬元	3Q-25	4Q-25	1Q-26	2Q-26	3Q-26	QoQ	YoY
現金及約當現金	1,767	1,814	2,079	2,504	2,218	-11.4%	25.5%
按攤銷後成本衡量之金融資產 - 流動	581	689	479	436	462	6.0%	-20.6%
應收帳款及票據	1,425	1,643	1,719	2,197	2,864	30.3%	100.9%
存貨	830	921	1,166	1,460	1,829	25.3%	120.5%
總資產	7,355	7,966	9,275	11,007	12,349	12.2%	67.9%
短期借款	571	538	192	302	827	173.8%	45.0%
總負債	2,281	2,538	3,260	4,112	4,950	20.4%	117.0%
母公司業主之權益總計	4,499	4,821	5,381	6,306	6,773	7.4%	50.5%
資產報酬率(%) ROA	5.4%	6.3%	9.1%	11.9%	13.9%	+2.08 ppt	+8.5 ppt
股東權益報酬率(%) ROE	7.2%	8.6%	13.2%	17.9%	21.5%	+3.6 ppt	+14.3 ppt

* 股東權益報酬率為以母公司股東平均股權計算的年化數據

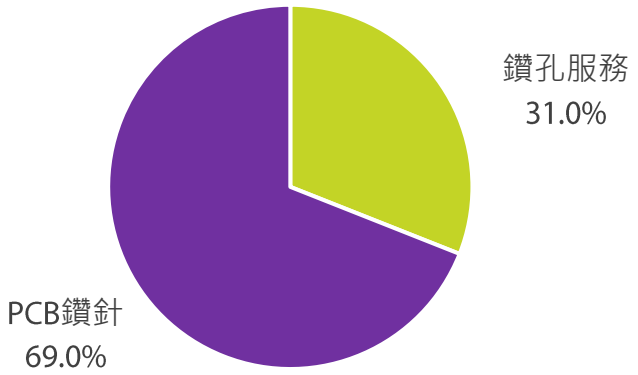
TOPOINT All Rights Reserved

26Q3 合併營收分析

合併營收

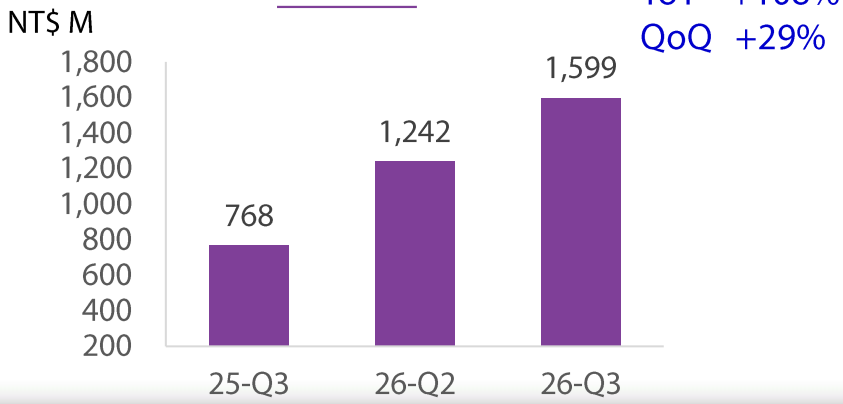


合併營收-按產品別

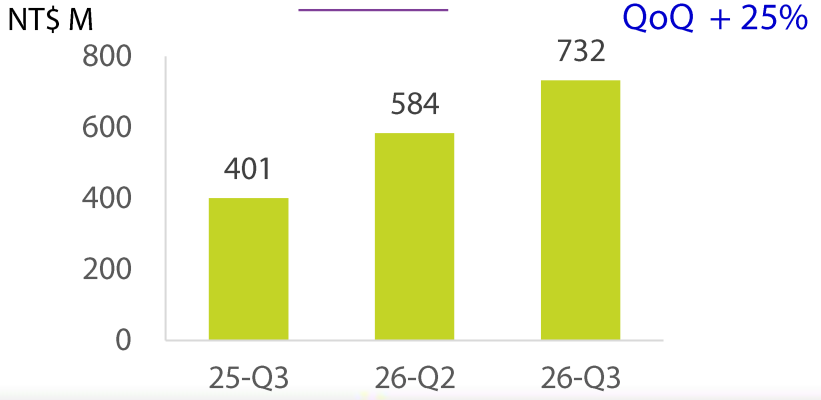


合併營收-按產品別

PCB鑽針



鑽孔服務



TOPOINT All Rights Reserved

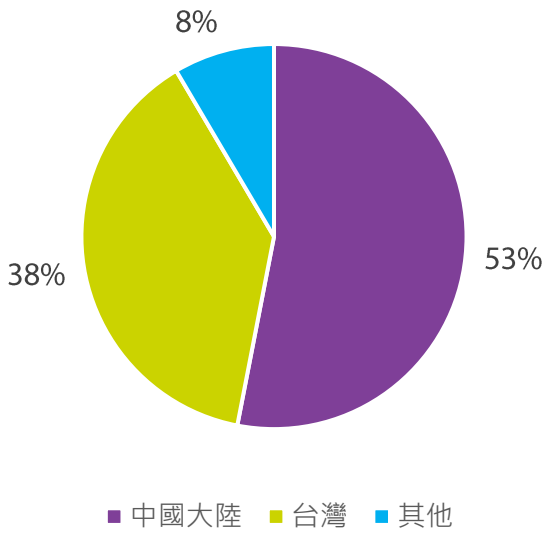
合併綜合損益表

NT$ 百萬元	2025/1/1~ 2025/9/30	2026/1/1~ 2026/9/30	年增(減)率
營業收入	3,069	5,496	79.1%
營業毛利	893	2,254	152.4%
營業費用	509	784	54.1%
營業利益	399	1,474	269.0%
稅前淨利	405	1,476	264.3%
淨利歸屬於本公司業主	240	899	275.1%
EBITDA	693	1,801	159.7%
EPS (元)	1.69	6.18	265.7%
毛利率%	29.1%	41.0%	+11.9ppt
營業利益率 %	13.0%	26.8%	+13.8 ppt
淨利率%	7.8%	16.4%	+8.6 ppt

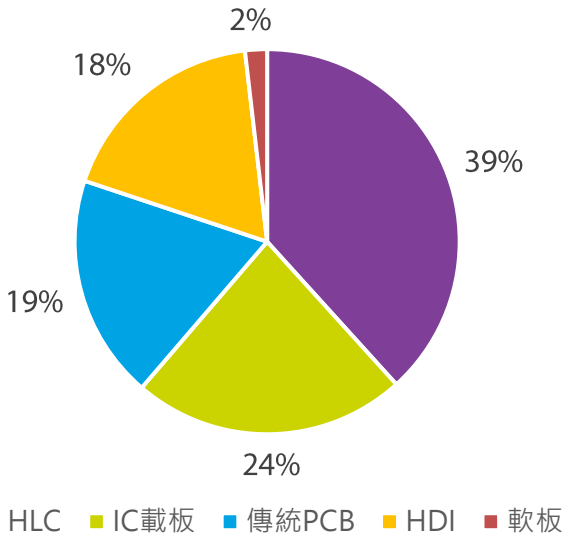
TOPOINT All Rights Reserved

26Q1-Q3 合併營收分析

合併營收-按銷售地區別



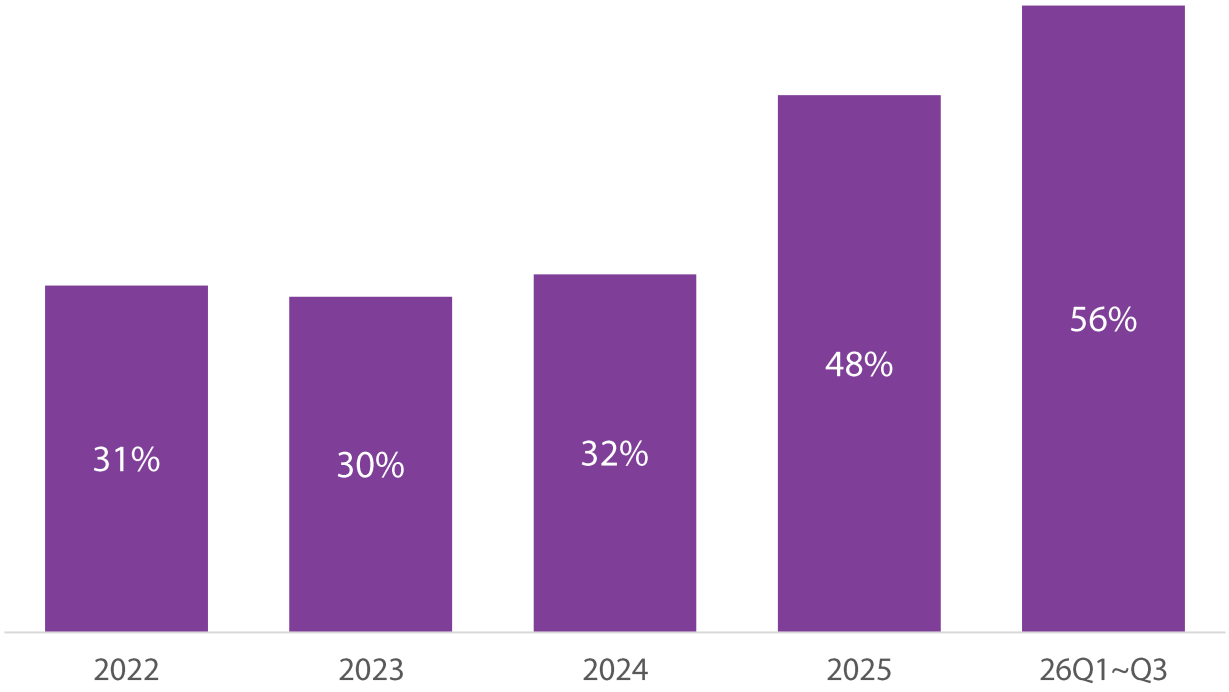
合併營收-按PCB產品別



TOPOINT All Rights Reserved.

高階鍍膜產品銷量比重

單位：%



TOPOINT All Rights Reserved

Q4及27年營運展望

- **高階需求持續成長，AI帶動產業升級**
  - AI算力與高速互連升級，推動PCB朝大尺寸、高多層及低損耗材料發展
  - 高階PCB加工難度提升，帶動高階鑽針與鑽孔需求成長
- **營運動能持續向上，2027年成長展望正向**
  - AI及高階PCB需求延續，第四季及2027年營運展望維持正向
  - 新產能陸續開出及產品組合優化，推動營收與獲利規模持續成長
- **擴產計畫有序推進，支應中長期成長需求**
  - 台灣T2、上海M5及M3三大新廠依計畫推進，產能陸續開出
  - 2026～2028年底鑽針月產能目標：4,500萬 / 7,000萬(↑) / 9,000萬(↑) pcs
  - 2027年持續擴充高階PCB鑽孔服務規模，深化雙軌布局
- **深化高階技術，持續提升產品價值**
  - 聚焦高縱橫比鑽針、特殊刀型及高性能鍍膜等關鍵技術
  - 2027年高階鍍膜鑽針占比可望進一步提升

TOPOINT All Rights Reserved

topoint®

Top the Perfection. Point to the Future.

For further information, please visit our website at:
www.topoint.tw

Contact Investor Relations at:
phone: +886-2-2680-5868
email: ir@topoint.tw